

产品简介

CE5150 是一款用于保护裸露半导体器材的包封材料。具有高纯度、低应力和良好的耐湿性能，可经受多次回流焊工艺。典型用于汽车电子、BGA、IC 存储卡、芯片载体、混合电路、COB、多芯片模块和插针网格阵列等。

固化前特性

	典型值	范围
外观	黑色液体	
化学类型	环氧树脂	
密度(g/cm ³)	1.7	
粘度(mPa.s)(Brookfield HB)	44000	
室温使用期 (天@25°C)	3	

推荐固化条件

125°C 固化 30min，升温至 165°C 固化 90min。

固化速度的快慢，取决于加热设备的加热效率和被加热 PCB 板的厚度以及芯片大小。要根据加热设备和被粘接物体适当的调节固化温度和固化时间。

固化后材料的特性

物理特性	典型值	测试标准
玻璃转化温度(°C)(TMA)	155	ASTM E1545

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址：山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话：0535-6105906 传真：0535-6105907



热膨胀系数 GB/T 1036-1989

α_1 (ppm/°C) 22

硬度(邵氏 D) 85 GB/T 2411-1980

吸水率(%)(24h@25°C) 0.25 GB/T 1034-1998

电性能

介电常数/介电损耗 GB/T 1693-2007

1MHz 3.5/0.01

体积电阻率($\Omega \cdot \text{cm}$) 5×10^{16}

离子含量(ppm)

Cl - < 5

K + < 1

Na + < 2

使用说明

1. 在使用前必须恢复到室温，在恢复到室温以前请不要打开包装。
2. 为达到最佳使用效果，基板需加热到 80°C。
3. 未用完的胶水，不允许重新冷冻。

注意事项

请远离儿童存放。

本品建议在通风良好的场所内使用。

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址：山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话：0535-6105906 传真：0535-6105907



若不慎沾到皮肤上，请马上用肥皂水清洗。

若不慎沾到眼睛上，请先用大量的水清洗，然后就医。

详细内容请参阅本品的 MSDS。

包装规格

30cc /支

贮存条件

在-40°C洁净、干燥处贮存。

贮存期：9 个月。

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址：山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话：0535-6105906 传真：0535-6105907